**ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG**

**[SAMTEC LOGO] Juli 2021**

**Samtec bringt mit AcceleRate® HP die neue Generation Hochleistungs-Arrays auf den Markt**

*Grundsystem für neue PICMG COM-HPC®-Steckverbindungslösungen*

**New Albany, Indiana (USA):** Samtec, ein 800 Mio. US-Dollar schwerer und in privater Hand befindlicher, globaler Hersteller eines breitgefächerten Angebots an elektronischen Verbindungslösungen, gibt stolz die Einführung der nächsten Generation AcceleRate HP High-Performance Arrays bekannt. AcceleRate HP unterstützt auf geringstem Raum unglaubliche 112 Gbit/s PAM4 und das High-Performance Array ermöglicht durch die offene Kontaktfeldauslegung eine maximale Flexibilität bei Masse- und Signalführung.

So können Systemarchitekten die leistungsfähige symmetrische DP-Signalübertragung, die asymmetrische SE-Übertragung und die hochstromige Spannungsversorgung über dieselbe Steckverbindung realisieren.

Darüber hinaus vereinfachen die großen Abstände zwischen den 4 Kontaktreihen (2,2/2,4/2,2 mm) die Führung der differentiellen Signalübertragung. Das Übersprechen wird durch die weiteren Abstände und die Möglichkeit verringert, mehr Masse-Vias um die differentielle Signalleitung herum zu gruppieren.

„Die neuen High-Performance Arrays aus der AcceleRate HP-Familie von Samtec setzen den Standard für die Datenübertragung mit 112 Gbit/s PAM4 in kleinem Formfaktor“, sagte Michael Boone, Produktmanager für High-Speed Board-to-Board bei Samtec. „Schnell wachsende Anwendungen wie zum Beispiel AI-Beschleunigerkarten, ASIC-Emulatoren und moderne Rechenplattformen nutzen diese einzigartigen Vorteile.“

Kernmerkmale der AcceleRate HP High-Performance Arrays:

* Hohe Kontaktdichte dank 0,635 mm Raster
* Steckhöhen von 5 mm oder 10 mm
* Bis zu 400 Kontakte gesamt
* Geplant sind 1000+ Kontakte
* Datenrate ausreichend für PCIe 5.0 und 100 GbE
* BGA-Anschlusstechnik für einfache Montage; versatztoleranter Steckvorgang

Weiterführende Informationen zu den Hochleistungsarrays AcceleRate HP finden Sie auf [www.samtec.com/accelerateHP](http://www.samtec.com/accelerateHP).

**PICMG COM-HPC Steckverbinder**

Die neue Spezifikation nach PICMG COM-HPC bietet mit dem Konzept eines 400-Kontakt-Steckverbinderpaares auf Basis der AcceleRate HP High-Performance Arrays von Samtec deutlich mehr System- und Schnittstellenflexibilität. Die COM-HPC-Steckverbinder von Samtec verbinden das Carrier-Board mit den Server- und Client-Modulen. Es werden aktuelle und kommende Schnittstellen wie PCIe 5.0 und bis zu 100 GbE unterstützt. Das Steckverbinderpaar ist mit einer Steckhöhe von 5 mm oder 10 mm erhältlich.

Für weiterführende Informationen zu den COM-HPC-Steckverbindern von Samtec laden Sie sich bitte die eBroschüre COM-HPCInterconnect Solutions herunter, besuchen [www.samtec.com/COMHPC](http://www.samtec.com/COMHPC) oder wenden sich per E-Mail [COMHPC@samtec.com](mailto:COMHPC@samtec.com) an die Fachleute unserer technischen Abteilung.

**Über Samtec**  
Das 1976 gegründete Privatunternehmen Samtec mit einem Jahresumsatz von 800 Mio. US-Dollar ist ein weltweit aufgestellter Hersteller einer breiten Palette an elektronischen Verbindungslösungen. Dazu gehören Hochgeschwindigkeits-B2B-Steckverbinder und -kabel, optische Mid-Board- und Panel-Einheiten, Verbinder mit flexibler Steckhöhe, robuste Bauelemente und Kabel im Mikroformat sowie präzise HF-Technik. Samtec verfügt über 40 internationale Standorte und verkauft seine Produkte in mehr als 125 Länder. Diese globale Präsenz macht die bislang unerreichte Qualität des Kundendienstes möglich. Weiterführende Informationen finden Sie auf [http://www.samtec.com](http://www.samtec.com/).

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Telefon: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[**www.samtec.com**](http://www.samtec.com)

###

**Kontakt PR:**

Matt Burns

[matthew.burns@samtec.com](mailto:matthew.burns@samtec.com)

+1 812-944-6733